

采用 SnPb (锡铅) BGA 封装的 μ Module 电源产品 适用于国防、航空电子和重型设备

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 6 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超过 53 款采用 SnPb BGA 封装的 μ Module[®] (微型模块) 电源产品, 这些产品面向优先使用锡铅焊接方法的应用, 例如国防、航空电子和重型设备行业。采用 SnPb BGA 封装的 μ Module 负载点稳压器具备以下特点, 简化了这些行业供应商的 PC 电路板组装:

- 采用表面贴装而不是通孔式 PCB 组装方式。
- 在一个 BGA 封装内提供完整、密封的 DC/DC 稳压器电路, 而不是采用很多组件和未经验证的分立式解决方案。
- 100% 经过测试的负载点稳压器解决方案, 而不是需要验证和监察的分立电路负载点稳压器解决方案。
- 由于具有比扁平 LGA 或 QFN 封装更高的支座, 因此在 μ Module BGA 封装下方进行清洁比较容易。
- 回流焊温度与 PCB 上其他锡铅组件相同, 而不像采用无铅焊膏的负载点稳压器那样需要较高的温度。


采用 SnPb BGA 封装的 μ Module 电源产品按照 DC/DC 转换器的不同分成四类: (1) 提供单输出和多输出的升压型或降压型转换器; (2) 降压-升压型转换器; (3) 隔离式转换器; (4) 具 PMBus 数字遥测及数据 READ 和 WRITE 功能的转换器。

这些器件的无铅 (SAC305) 版本以及超过 100 种采用 BGA 和 LGA 封装的 μ Module 产品可通过 www.linear.com.cn/umodule 查询详情。

点击[这里](#)或访问 <http://lt.linear.com/00w>, 查看 SnPb BGA 微型模块电源产品概述。

凌力尔特公司简介

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员, 在过往的 30 多年, 一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁, 应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、 μ Module[®] 子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息, 请登录 www.linear.com.cn。

、LT、LTC、LTM、Linear Technology、Linear 标识和 μ Module 是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。

媒体垂询:

刘佩芬 (Fanny Lau)
flau@linear.com
电话: 852-2428 0303

敖琼 (Angela Ao)
angela.ao@ebacomms.com
电话: 86-10-6522 8081

John Hamburger
jhamburger@linear.com
电话: 408-432 1900 ext 2419

Doug Dickinson
ddickinson@linear.com
电话: 408-432 1900 ext 2233